

证券代码：002845

证券简称：同兴达

深圳同兴达科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20260513

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年业绩说明会的投资者
时间	2026年05月13日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 万锋 财务总监、董事 李玉元 董事会秘书 李岑 独立董事 卢绍锋 投资总监 姚拥军
投资者关系活动主要内容介绍	1.（1）传闻TCL将要入资昆山同兴达进展如何了？（2）年中多大机会扭亏为盈？（3）封装是否要建二厂？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关心与关注，相关信息请您关注公司在指定信息披露媒体发布的公告。

2. 公司在车载显示模组领域的客户导入情况如何？目前已进入哪几家新能源车企的供应链体系？

答：尊敬的投资者您好，公司在车载领域已完成显示模组与光学摄像头模组的业务布局，其中车载摄像头模组业务由全资子公司南昌同兴达汽车电子有限公司承载。2025年，子公司南昌同兴达汽车电子经过紧张有序的筹备及客户拓展，与长城、吉利、奇瑞等多家知名车企合作持续加强，已有多项合作项目顺利落地。目前公司车载相关产品已应用于车载领域，显示模组业务与光学摄像头模组业务均已实现车载领域的覆盖。感谢您对公司的关注。

3. 在折叠屏手机显示模组方面的技术储备及量产进度如何？是否有新增的头部手机厂商订单？

答：您好，目前我司正在折叠屏手机显示模组技术领域进行持续研发和布局，同时加强与行业头部厂商的技术交流，谢谢！

4. 今年公司在研发投入上重点投向了哪些细领域？

答：感谢您对公司的关注。今年公司在研发投入上重点有以下方向：OLED 技术、中尺寸模组、LiPo 技术、国产材料替代技术、新能源材料及应用技术、连续光变与多群组2亿像素潜望摄像头、1英寸可变光圈与3~5度大角度防抖OIS摄像头；全景三维、手持式及无人机主摄像头、产品的BUMP非金属材料（替代金属材料）技术等。

5. 公司在VR/AR显示模组领域的布局情况，是否有实质性的量产订单落地？

答：1、尊敬的投资者，您好！我司在VR/AR领域进行了前瞻性的研发布局，但目前还没有实质性量产订单落地，谢谢！

6. 目前在海外市场的布局进展如何？越南或印度工厂的产能贡献率如何？

答:尊敬的投资者您好,公司目前在海外只设立了印度工厂,印度工厂已满产,订单情况饱和。若后续相关事项达到信息披露标准,公司会依规对外披露。感谢您对公司的关注。

7. 管理层如何看待今年全年的营收增长目标?

答:尊敬的投资者您好,2026年公司将围绕多项核心业务布局规划,一是持续巩固液晶显示模组业务的领先地位,提升市场份额;二是将投入优质资源推进半导体先进封测项目产能顺利释放,抓住显示驱动芯片封测产业链本土化的市场机遇,为业绩增长贡献力量;同时将多维度推进光学摄像头和车载摄像头业务高质量发展,紧抓汽车智能化带来的市场增量;新成立的新能源产品事业部相关产品计划2026年外销推向市场,将进一步拓宽公司业绩增长空间;此外公司还将进一步推动数字化经营,提升综合运营实力,同时持续巩固和扩大市场份额,为全年经营发展奠定基础。感谢您对公司的关注。

8. 制定该分红方案的主要考虑是什么?未来公司是否有提高分红比例的计划?

答:感谢您对我司的关注。公司2025年“10派0.4元”现金分红方案,核心是平衡股东回报与公司发展资金需求,在合规前提下匹配行业周期与战略投入。后续是否有提高分红比例的计划请详见公司公告。

9. 去年年末为啥存货增加?今年如何优化存货?

答:尊敬的投资者,您好!公司去年营收增长存货同步增长,以及还做了部分存货战略备料,以及车载汽车销售量大幅增加对应的存货增加。感谢您对公司的关心与关注。

10. 公司25年摄像类产品实现营收35.99亿元,同比增长27.64%,成为公司增长主力,但毛利率仅为4.89%,同比仅提升0.47个百分点。请问摄像类产品毛利率偏低的主

要原因是什么？今年采取哪些措施提示盈利？

答:尊敬的投资者，您好！摄像类产品毛利率偏低主要是上半年会低些，下半年上升趋势良好，公司优化客户结构，积极引进盈利能力强且持续的客户，相信今年盈利能力能大幅提升。感谢您对公司的关心与关注。

11. 昆山日月同芯目前主要产品为显示驱动 IC 封测，请问公司在先进封测技术方面有哪些储备？是否有计划拓展其他类型芯片的封测业务，如车载芯片、AI 芯片等？

答:您好，公司控股子公司昆山日月同芯在半导体先进封测技术方面已有充足储备：目前已掌握并沉淀了金/铜镍金凸块Bump、FC等先进封装的关键技术，持续研发储备了化学镀、硅通孔（TSV）、重布线（RDL）和混合键合（Hybrid Bonding, HB）等关键技术；在非显示类芯片封测领域，公司已开发出铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等各类凸块制造技术，同时也在对Chiplet等相关先进封装技术进行预研及储备，目前已拥有行业内先进的28nm制程显示驱动芯片的封测量产能力，核心技术指标处于行业领先水平。日月同芯当前项目主要聚焦显示驱动芯片的封装测试，依托已掌握的先进封测核心技术与持续的研发储备，公司已经为后续开展包括车载芯片、AI芯片等其他类型半导体先进封装业务做好了相关准备，2026年公司也将投入优质资源推进该封测项目的建设发展，抢抓产业链本土化带来的市场机遇。感谢您对公司的关注。

12. （1）公司昆山封测厂，目前是否有华为/海思任何芯片封测、金凸块批量订单？（2）公司和华为现有合作只有显示模组、摄像头吗？芯片封测环节有没有切入华为供应链、有无送样、有无认证？（3）市场传闻公司切入华为先进封装、Chiplet相关业务，是否属实？有落地时间表吗？

	答:您好, 基于客户商务保密要求暂不方便透露, 相关信息请您关注公司在指定信息披露媒体发布的公告, 谢谢!
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单 (如有)	
日期	2026年05月13日